

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2021-057

## 苏州晶方半导体科技股份有限公司

### 2021年半年度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

1、经苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 26,000 万元至 27,500 万元，同比增长 66.61%至 76.22%。

2、扣除非经常性损益事项后，预计 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为 23,000 万元至 24,500 万元，同比增长 78.20%至 89.82%。

#### 一、本期业绩预告情况

##### （一）业绩预告期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。

##### （二）业绩预告情况

1、经公司财务部门初步测算，预计 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 26,000 万元至 27,500 万元，同比 2020 年半年度的 15,605.71 万元增长 66.61%至 76.22%。

2、扣除非经常性损益事项后，预计 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为 23,000 万元至 24,500 万元，同比 2020 年半年度的 12,906.92 万元增长 78.20%至 89.82%。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

#### 二、本期业绩预增的主要原因

（一）随着5G、AIOT、算力算法的趋势性发展与提升，以摄像头为代表的传感器产品应用场景越来越丰富，推动手机多摄像趋势不断渗透、安防数码监控市场持续增长、汽车摄像头应用逐步普及、机器视觉应用快速兴起，使得公司2021年上半年生产订单持续饱满，产能与生产规模同比显著提升。

（二）为把握市场机遇，公司不断加强封装技术工艺的拓展创新，汽车电子等新应用领域量产规模稳步推进，中高像素产品逐步导入量产、Fan-out技术在大尺寸高像素领域的应用规模逐步扩大、芯片级与系统级SiP封装规模不断提升、晶圆级微型镜头业务开始商业化应用。

（三）为满足订单的持续增长，公司持续推进生产能力的规划与扩充，运营效率与管理水平的内部挖潜提升。

### 三、风险提示

公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

### 四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2021年7月13日